

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—033

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称 及人员姓名	东北证券：武芃睿 方以资产：陈赢
时间	2026 年 9 月 8 日
地点	国机精工会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：赵祥功 董事会办公室主任：赵金伟 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	1. 问：超硬材料磨具业务开展情况如何？ 答：2026 年上半年，超硬磨具业务收入 3.72 亿元左右，下游应用分半导体领域和非半导体（汽车、制冷、LED、工模具等）领域。其中用于半导体领域的产品近几年增长较为显著，上半年同比增速约 40%。公司超硬材料磨具产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争对手基本为国际跨国企业。 2. 问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？ 答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头。产品种类上，金刚石工具类已覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀等产品类型，精密陶瓷制品类已覆盖陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品类型。 3. 问：公司金刚石工具业务的情况？ 答：公司在半导体领域金刚石工具产品上处于行业领先地位，主要包括划片刀、封装刀、减薄砂轮等产品，用于晶圆减薄、芯片划切与封装测试环节，是目前公司超硬磨具业务最核心的增长来源。不过公司该类产品与海外龙头仍存在差距，将持续加大技术研发投入，迭代优化产品性能与生产工艺。

	4. 问：公司精密陶瓷制品业务的情况？ 答：公司在半导体领域精密陶瓷产品上处于行业领先地位，该类产品包括陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等。应用在半导体领域的精密陶瓷制品，技术开发难度大，产品技术壁垒较高，市场前景好，是公司未来几年重点推广的产品，公司将加快其市场导入，持续提升市场占有率。 5. 问：公司半导体耗材的客户结构如何？ 答：公司半导体客户按产品类型分布较清晰。金刚石工具对应的客户集中于封装领域，精密陶瓷制品客户以半导体设备厂为主。 6. 问：金刚石散热主流产品类型及市场如何比较？ 答：行业内主流产品分为单晶金刚石散热片、多晶金刚石散热片和金刚石铜复合材料三大类。单晶金刚石散热片热导率约 2000W/m·K 以上；多晶金刚石散热片的热导率约 1500W/m·K；金刚石铜复合材料热导率约 800W/m·K。市场主要从生产成本、生产工艺、下游适配场景等维度综合评估。 7. 问：公司在金刚石散热领域的产品布局和进展？ 答：目前，金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域，2025 年实现收入超 1000 万元。 在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD 金刚石产品（含单晶与多晶）已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。 8. 问：公司是否有金刚石钻针产品？ 答：公司拥有金刚石微钻产品，当前仅在航空碳纤维打孔领域实现应用，暂未布局半导体领域。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所	无

使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
----------------------------	--